

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.4/2562
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557

(非公式訳)

投資委員会布告

第 Sor. 4/2562 号

件名：投資委員会布告第 2/2557 号に基づく

投資奨励対象業種表の改定

仏暦 2557 年（2014 年）12 月 3 日付投資委員会布告第 2/2557 号「投資奨励政策および基準」につき、

電気製品と電子製品向けの迅速な技術開発に関し、タイが高度技術を持つ製品の生産拠点になることを目的とし、

仏暦 2520 年（1977 年）投資奨励法第 16 条の第 2 段落および第 18 条の権限に基づき、投資委員会は仏暦 2557 年（2014 年）12 月 3 日付投資委員会布告第 2/2557 号巻末の業種 5.3.8 を追加し、業種 5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.2.3、5.2.6、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6、5.3.7、5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.9、5.4.12 および 5.4.14 の内容を廃止し以下の内容を代わりに使用することで、5 類 電気・電子機器産業の投資奨励対象業種を改定することを公布する。

5 類 電気・電子機器産業

業種	条件	恩典
5.1.1 スマート電気製品の製造 (SMART ELECTRICAL APPLIANCES)	1. スマート電気製品は以下の性質を有しなければならない。 1.1 主要部品としてデータ検出・受信ができる電子部品を有する。 1.2 無線通信システムを通じて他の装置もしくは機器、またはネットワークに接続することができる。 1.3 その装置もしくは機器の本体にオペレーティングシステムまたは処理システムが組み込まれる。 2. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間における総売上高の 0.5%以上または 1 億バーツ以上（いずれか少ない方）であること 3. 他の場合	A 2 A 3

業種	条件	恩典
5.1.2 エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機の製造	エネルギー省の高効率規格（省エネラベル5 番）または他の同等のエネルギー効率規格を得た商品であること。	A 4
5.1.3 その他電気製品の製造	1. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の3 年間ににおける総売上高の0.5%以上または1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること 2. 他の場合	A 3 B 1
5.2.3 電気製品用コンプレッサーおよび/ またはモーターの製造	モーター製造の場合は、製品設計の工程を有すること。	A 4
5.2.6 蓄電装置の製造		
5.2.6.1 高密度蓄電池（High Density Battery）の製造	出力密度の特性および充電回数は委員会の同意を得なければならない。	A 2
5.2.6.2 スーパーキャパシタの製造	エネルギー密度の特性および充電回数は委員会の同意を得なければならない。	A 2
5.2.6.3 電池の製造（鉛蓄電池を除く）		B 1
5.3.2 電気通信機器の製造		
5.3.2.1 光ファイバーおよび無線通信システムに使用される発光、送信、受信機器の製造	1. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の3 年間ににおける総売上高の0.5%以上または1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること 2. 他の場合	A 2 A 3
5.3.2.2 その他電気通信機器の製造	1. 以下の条件に満たす場合 1.1 ライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用するPCBA 生産ラインへの投資を有する。 1.2 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の3 年間ににおける総売上高の0.5%以上または1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること。	A 2

業種	条件	恩典
	2. ライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用する PCBA 生産ラインへの投資を有する場合	A 3
	3. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間に於ける総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること	A 3
	4. 他の場合	A 4
5.3.3 高い精度で測定できるセンサーを有する工業・農業用電子制御および測定機器の製造	1. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間に於ける総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること 2. 他の場合	A 2 A 3
5.3.4 指紋スキャナーまたは網膜スキャナー等高い精度で測定できるセンサーを有する安全管理機器の製造	1. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間に於ける総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること 2. 他の場合	A 2 A 3
5.3.5 オーディオビジュアル機器製品(Audio Visual Product) の製造	1. 以下の条件に満たす場合 1.1 ライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用する PCBA 生産ラインへの投資を有する。 1.2 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間に於ける総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること。 2. ライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用する PCBA 生産ラインへの投資を有する場合 3. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間に於ける総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること 4. 他の場合	A 2 A 3 A 3 A 4

業種	条件	恩典
5.3.6 事務用電子機器の製造	1. 以下の条件に満たす場合	A 2
	1.1 ライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用する PCBA 生産ラインへの投資を有する。	
	1.2 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間における総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること。	
	2. ライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用する PCBA 生産ラインへの投資を有する場合	A 3
	3. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間における総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること	A 3
	4. 他の場合	A 4
5.3.7 その他電子製品の製造	1. 以下の条件に満たす場合	A 3
	1.1 ライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用する PCBA 生産ラインへの投資を有する。	
	1.2 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間における総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること。	
	2. ライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用する PCBA 生産ラインへの投資を有する場合	A 4
	3. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の 3 年間における総売上高の 0.5%以上または 1 億パーツ以上（いずれか少ない方）であること	A 4
	4. 他の場合	B 1

業種	条件	恩典
5.3.8 スマート・エレクトロニクスの製造 (SMART ELECTRONICS)	1. スマート・エレクトロニクスは以下の性質を有しなければならない。 1.1 主要部品としてデータ検出・受信ができる電子部品を有する。 1.2 無線通信システムを通じて他の装置もしくは機器、またはネットワークに接続することができる。 1.3 その装置もしくは機器の本体にオペレーティングシステムまたは処理システムが組み込まれる。 2. 研究開発への投資もしくは支出が、奨励申請日より最初の3年間における総売上高の0.5%以上または1億バツ以上（いずれか少ない方）であること 3. 他の場合	A 2 A 3
5.4.3 電気通信機器部品の製造		
5.4.3.1 光ファイバーおよび無線通信システムにおける発光、送信、受信機器部品の製造	1. 製品のオペレーションに重要な部品であること 2. 他の部品のこと	A 2 A 3
5.4.3.2 その他電気通信機器部品の製造	1. 製品のオペレーションに重要な部品であること 2. 他の部品のこと	A 2 A 3
5.4.4 高い精度で測定できるセンサーを有する工業用、農業用、医療／科学機器用、乗り物用電子制御および測定機器部品の製造	1. 製品のオペレーションに重要な部品であること 2. 他の部品の場合	A 2 A 3
5.4.5 指紋スキャナーまたは網膜スキャナー等高い精度で測定できるセンサーを有する安全管理機器部品の製造	1. 製品のオペレーションに重要な部品であること 2. 他の部品の場合	A 2 A 3

業種	条件	恩典
5. 4. 9 半導体および/ または半導体部品の製造 (Wafer Grinding、Sawed Dice、Wafer Testing、 IC Testing、 IC Module など製造工程の間に発生するまたは上記の製造工程を有する製品を含む)	集積回路 (Integrated Circuit) の製造に使用される既存機械の改修に対する投資は、投資プロジェクトの一部とみなすが、既存機械の取得費用は法人所得税免税対象金額に含めない。	A 3
5. 4. 12 フレキシブルプリント基板及び/ またはプリント基板及び/ またはその部品の製造		A 2
5. 4. 12. 1 回路パターン設計の工程を有するフレキシブルプリント基板及び/ または多層プリント基板及び/ またはその部品の製造		A 3
5. 4. 12. 2 回路パターン設計の工程のないフレキシブルプリント基板及び/ または多層プリント基板及び/ またはその部品の製造		A 4
5. 4. 11. 3 回路パターン設計の工程を有する他の種類のフレキシブルプリント基板及び/ またはその部品の製造		B 1
5. 4. 11. 4 回路パターン設計の工程のない他の種類のフレキシブルプリント基板及び/ またはその部品の製造		

業種	条件	恩典
5.4.14 一般プリント回路板組立（PCBA）または同一プロジェクトに PCBA の製造工程を有す製品の製造	同一プロジェクトにライン全体で表面実装（Surface Mount Technology）技術を使用する PCBA 組み立て工程を有しなければならない。	A 4

仏暦 2562 年（2019 年）11 月 1 日以降提出され、かつ本布告の施行時点で奨励認可されていない奨励申請書に適用される。本布告に基づき奨励付与を検討する。

尚、只今より有効とする。

公布日：仏暦 2562 年（2019 年）12 月 13 日

プラユット・チャンオーチャー

首相

投資委員会委員長